

General Announcement

Document # : GA22636X Issue Date: 13 February 2019

Title of Change:	Notice of temporary suspension of ISO 9001 Certification for Hitachi Chemical Co., Ltd. (a supplier to ON Semiconductor)	
Effective date:	Not applicable	
Contact information:	Contact < <u>quality@onsemi.com</u> >	
Type of notification:	ON Semiconductor considers this change approved.	
Change category:	☐ Wafer Fab Change ☐ Assembly Change	☐ Test Change ☐ Other
Change Sub-Category(s): ☐ Manufacturing Site Change/Addition ☐ Material Change ☐ Product specific change		 □ Datasheet/Product Doc change □ Shipping/Packaging/Marking ☑ Other: supplier ISO 9001 certificate suspension

Description and Purpose:

In January of 2019 ON Semiconductor was informed that the ISO 9001 certificate for one of our suppliers, Hitachi Chemical — Yamazaki plant, has been suspended due to falsification of records. Products impacted include Polyimide, Interlayer dielectric materials (HSG) and CMP Slurry. These materials are widely used throughout the semiconductor industry and it is expected that they may also be used by other semiconductor manufacturers.

We want to inform and reassure our customers that ON Semiconductor is performing the requisite due diligence in this situation to ensure the quality of ON Semiconductor product, which use the impacted materials, is not compromised. Hitachi initially informed ON Semiconductor of the falsification of data issue in October 2018, since that time we have taken the following measures to determine any potential impact on the quality of products delivered to our customers.

- 1) Although the Hitachi Chemical manufacturing locations which supply ON Semiconductor with epoxy mold compounds were not implicated in the data falsification issue, we have taken the extra step of reviewing our internal reliability qualification testing and monitoring data, for our products manufactured with Hitachi epoxy mold compound, along with other internal manufacturing and quality data. We have not observed any detrimental impact to the quality and reliability to our products using these materials and we do not foresee any impact to our customers.
- 2) The CMP slurry does not become any part of the wafer/die and is a consumable during the fab process. We have not observed any detrimental impact to the quality and reliability of our products which were processed using the CMP slurry and we do not foresee any impact to our customers.
- 3) ON Semiconductor Supplier Quality engineers visited the affected Hitachi plant, checking product quality and records, no major deviation form material specifications were observed.
- 4) ON Semiconductor Supplier Quality engineers conducted an extensive audit of the Hitachi Chemical Yamazaki facility on January 22 24, 2019
 - a. The audit revealed that following the implementation of corrective actions, current procedures at the Hitachi Chemical Yamazaki plant are in control and there is no deviation from product specifications.
- 5) We have received and reviewed the corrective action plan submitted by Hitachi to their registrar, LRQA, and found it sufficient to ensure this issue doesn't occur again.
 - a. Root cause has been identified
 - b. Appropriate corrective actions are in place to address the root cause

ON Semiconductor is dedicated to operating in an ethically responsible manner and has the same expectations throughout our supply chain.

TEM001800 Rev. O Page 1 of 1

Japanese translation of the notification starts here. 通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注:日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます.



一般的なお知らせ

文書番号#:GA22636X 発行日:13 February 2019

変更件名:	日立化成株式会社に対する ISO 9001 認証の一時停止の通知 (オン・セミコンダクターへのサプライヤ)	
発効日:	該当なし	
連絡先情報:	<quality@onsemi.com>に連絡してください。</quality@onsemi.com>	
通知種別:	オン・セミコンダクタは、この変更が承認されたと見なします。	
変更カテゴリ:	▼ ウェハファブの変更	
変更サブカテゴリ: 製造拠点の追加	□ ボータシート/製品資料の変更	
□ 製造拠点の移転□ 製造プロセスの変更	□ 出荷/パッケージング/表記□ 製品仕様の変更▼ その他: サプライヤ ISO 9001 認定の一時停止	

説明および目的:

2019 年 1 月にオン・セミコンダクターは、サプライヤの一つである日立化成山崎事業所が、記録の改ざんにより ISO 9001 認証が停止されたとの通知を受けました。影響を受ける製品には、ポリイミド、層間絶縁膜材 (HSG) および CMP スラリーが含まれます。 これらの材料は、半導体産業を通して幅広く使用されているために、他の半導体製造業者も使用していることが予想されます。

オン・セミコンダクターはこの状況において、関連する材料を使用しているオン・セミコンダクター製品が悪影響を受けていないことの品質を保証するために必須のデューデリジェンスを実行していることをお知らせしお客様の不安を解消致します。日立は当初、オン・セミコンダクターにデータ改ざん問題について 2018 年 10 月に通知してきました。それ以降、弊社は、お客様に出荷した製品の品質に対して可能性のある影響を決定するために以下の対策を取ってきました。

- 1) オン・セミコンダクターにエポキシモールドコンパウンドを供給している日立化成の製造拠点はデータ改ざん問題に関与しておりませんでしたが、弊社は、他の内部製造および品質データと共に、日立エポキシモールドコンパウンドを使用して製造する製品に対して、自身の内部信頼性認定試験およびモニターデータに関してレビューする特別なステップを取りました。その結果、これらの材料を使用した製品の品質および信頼性に関して、いかなる悪影響も観測されず、お客様へのいかなる影響も予見することはありません。
- 2) CMP スラリーはウェハ/ダイのいずれの部分にもなっておらず、ファブプロセスにおいての消耗品です。CMP スラリーを使用してプロセスされた製品の品質および信頼性に関して、いかなる悪影響も観測されず、お客様へのいかなる影響も予見することはありません。
- 3) オン・セミコンダクターサプライヤ品質エンジニアが関連する日立の工場を訪れ、製品品質および記録を検証し、材料仕様書からの大きな逸脱がないことを確認しました。
- 4) オン・セミコンダクターサプライヤ品質エンジニアは、2019 年 1 月 22 日から 24 日にかけて、日立化成山崎事業所において広範囲な監査を実施しました。
 - a. 監査により、是正処置の履行に従い、日立化成山崎事業所における現状の手順は管理下にあり、製品仕様書から逸脱がないことが確認されました。
- 5) 弊社は、日立から登録機関である LRQA へ提出された是正処置計画を受領して検証し、本問題は再び発生しないことを 保証するに十分であることを確認しました。
 - a. 根本的原因は特定されています。
 - b. 根本的原因に対処するように適切な是正処置が取られています。

オン・セミコンダクターは、倫理的に責任ある態度で操業することに全力を尽くし、弊社のサプライチェーンを通しても同様の内容を期待しています。

TEM001800 Rev. A 1/1 ページ